

# 2020-2026年中国IC先进 封装行业分析与产业竞争格局报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2020-2026年中国IC先进封装行业分析与产业竞争格局报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202002/152778.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

### 报告目录

#### 第一章 IC封装产业相关概述

##### 第一节 IC封装涵盖

##### 第二节 IC封装类型阐述

###### 一、SOP封装

###### 二、QFP与LQFP封装

###### 三、FBGA

###### 四、TEBGA

###### 五、FC-BGA

###### 六、WLCSP

##### 第三节 明日之星——TSV封装

###### 一、TSV简介

###### 二、TSV与SoC

###### 三、TSV产业与市场

#### 第二章 2016-2019年世界IC封装产业运行态势分析

##### 第一节 2016-2019年世界IC封装业运行环境浅析

###### 一、全球经济大环境及影响分析

###### 二、全球集成电路产业运行总况

##### 第二节 2016-2019年世界IC封装运行现状综述分析

###### 一、IC封装产业热点聚焦

###### 二、IC封装业新技术应用情况

###### 三、全球IC封装基板市场分析

###### 四、全球IC封装材料市场发展

###### 五、全球IC封装生产企业向中国转移

##### 第三节 2016-2019年世界IC封装重点企业运行分析

###### 一、英特尔（Intel）

###### 二、IBM

###### 三、超微

###### 四、英飞凌（Infineon）

## 第四节 2020-2026年世界IC封装业趋势探析

## 第三章 2016-2019年中国IC封装行业市场运行环境解析

### 第一节 2016-2019年中国宏观经济环境分析

- 一、国民经济增长
- 二、中国居民消费价格指数
- 三、工业生产运行情况
- 四、房地产业投资情况
- 五、中国制造业采购经理指数

### 第二节 2016-2019年中国IC封装市场政策环境分析

- 一、电子产业振兴规划解读
- 二、IC封装标准
- 三、内需拉动业，IC业政策与整合是关键
- 四、相关行业政策及对IC封装产业的影响

### 第三节 2016-2019年中国IC封装市场技术环境分析

- 一、高端IC封装技术
- 二、中高端IC封装技术有所突破
- 三、IC封装基板技术分析

## 第四章 2016-2019年中国IC封装产业整体运行新形势透析

### 第一节 2016-2019年中国IC封装产业动态聚焦

- 一、半导体封装基板项目落户无锡
- 二、国内IC封装及IC基板用硅微粉实施产业化
- 三、中国IC代工封装等已进入国际排行榜

### 第二节 2016-2019年中国IC封装产业现状综述

- 一、我国IC封装业正向中高端迈进
- 二、探秘中国IC封装产业变局
- 三、中国正成为全球IC封装中心
- 四、IC封装年产能分析

### 第三节 2016-2019年中国IC封装产业差距分析

- 一、工艺技术
- 二、质量管理

### 三、成本控制

#### 第四节2016-2019年中国IC封装产思考

- 一、技术上：引进和创新相结合
- 二、人才上：引进和培养相结合
- 三、资金上：资本运作是主要途径

### 第五章 2016-2019年中国IC封装技术研究

#### 第一节 2016-2019年中国IC封装技术热点聚焦

- 一、封装测试技术新革命来临
- 二、芯片封装厂封装技术或转向铜键合
- 三、RFID电子标签的封装形式和封装工艺
- 四、降低封装成本 提升工艺水平措施

#### 第二节 高端IC封装技术

- 一、IC制造技术
- 二、TAB Potting System
- 三、BGA,CSP Ball Mounting System
- 四、Flip-Chip Bonding System
- 五、TAB Marking System
- 六、TFT-LCD Cell Bonding System

### 第六章 2016-2019年中国IC封装测试领域深度剖析

#### 第一节 2016-2019年中国IC封装测试业运行总况

- 一、IC封装测试业外资独占鳌头
- 二、测试企业布局力度将加大
- 三、中高档封测产品占比将逐年提升
- 四、应对知识产权、环保考验

#### 第二节 新型封装测试技术

- 一、MCM(MCP)技术
- 二、SiP封装测试技术
- 三、MEMS技术
- 四、BCC封装技术
- 五、Flash Memory(TSOP)塑封技术

六、多种无铅化塑封技术

七、汽车电子电路封装测试技术

八、Strip Test(条式/框架测试)技术

九、铜线键合技术

## 第七章 2016-2019年中国IC封装产业主要数据监测分析（4053）

### 第一节 2016-2019年份中国IC封装行业规模分析

一、企业数量增长分析

二、从业人数增长分析

三、资产规模增长分析

四、销售规模增长分析

### 第二节 2016-2019年中国IC封装行业应收账款情况分析

### 第三节 2016-2019年中国IC封装行业产值分析

一、产成品增长分析

二、工业销售产值分析

### 第四节 2016-2019年中国IC封装行业成本费用分析

一、销售成本分析

二、费用分析

### 第五节 2016-2019年中国IC封装行业盈利能力分析

一、主要盈利指标分析

二、主要盈利能力指标分析

## 第八章 2016-2019年中国IC封装产业运行新形势透析

### 第一节 2016-2019年中国IC封装产业运行综述

一、大陆IC封装企业的分布及其特点

二、IC封装向高端技术迈一步

三、形成封装及自主品牌终端产业链

### 第二节 2016-2019年中国IC封装产业变局分析

一、IC封装业稳步发展，但产值比重有所下降

二、产业格局外企主导，行业竞争日益激烈

三、封装技术更新加快，国内水平显著提高

### 第三节 金融危机对中国IC封装业影响及应对分析

一、金融危机对封装业冲击较大

二、创新使IC封装企业成功渡过危机

#### 第四节 2016-2019年中国IC封装业面临的挑战分析

一、低档产品封装产能过剩,高端产品的封装刚刚起步

二、IC业“大进大出”的怪圈对封装业的成长提出了挑战

三、我国IC的相关行业配套能力差,也对封装业造成不利影响

四、技术相对滞后

五、国内封装企业自我研发能力差、研发投入不足

#### 第五节 对发展我国IC封装业的思考

### 第九章 2016-2019年中国IC封装细分市场运行分析

#### 第一节 手机IC封装市场

##### 第二节 手机基频封装

一、手机基频产业

二、手机基频封装

##### 第三节 智能手机处理器产业与封装

##### 第四节 手机射频IC

一、手机射频IC市场

二、手机射频IC产业

三、4G时代手机射频IC封装

##### 第五节 PC领域先进封装

一、DRAM产业近况

二、DRAM封装

三、NAND闪存产业现状

四、NAND闪存封装发展

五、CPU GPU和南北桥芯片组

### 第十章 2016-2019年中国封装用材料运行分析

#### 第一节 金线

#### 第二节 IC载板

### 第十一章 2016-2019年中国IC封装产业竞争新格局探析

## 第一节 2016-2019年中国IC封装竞争总况

- 一、封装市场竞争激烈
- 二、倒装芯片封装更具竞争力
- 三、封装低端市场竞争力加强
- 四、IC封装技术竞争力分析
- 五、外资加大中国市场布局对产业竞争的影响

## 第二节 2016-2019年中国IC封装产业集中度分析

- 一、市场集中度分析
- 二、生产企业集中度分析

## 第三节 2020-2026年中国IC封装竞争趋势分析

# 第十二章 2016-2019年中国半导体（集成电路）封装重点企业运营财务状况分析

## 第一节 长电科技（600584）

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

## 第二节 深圳赛意法微电子有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

## 第三节 南通富士通微电子股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析



## 六、企业成长能力分析

### 第四节 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

#### 三、企业盈利能力分析

#### 四、企业偿债能力分析

#### 五、企业运营能力分析

#### 六、企业成长能力分析

### 第五节 英特尔产品(成都)有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

#### 三、企业盈利能力分析

#### 四、企业偿债能力分析

#### 五、企业运营能力分析

#### 六、企业成长能力分析

### 第六节 无锡菱光科技有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

#### 三、企业盈利能力分析

#### 四、企业偿债能力分析

#### 五、企业运营能力分析

#### 六、企业成长能力分析

### 第七节 恒宝股份有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

#### 三、企业盈利能力分析

#### 四、企业偿债能力分析

#### 五、企业运营能力分析

#### 六、企业成长能力分析

### 第八节 南京汉德森科技股份有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

#### 第九节 深圳市比亚迪微电子有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

#### 第十节 常州市欧密格电子科技有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

### 第十三章 2019年中国芯片封装重点企业关键性财务指标分析

#### 第一节 安靠封装测试(上海)有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

#### 第二节 沛顿科技(深圳)有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

### 第三节 淄博凯胜电子科技有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

### 第四节 河南鼎润科技实业有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

### 第五节 盟事达智能卡技术(深圳)有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

## 第十四章 2016-2019年中国封装材料企业运营竞争性指标分析

### 第一节 汉高华威电子有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

## 第二节 厦门惠利泰化工有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

## 第三节 福建易而美光电材料有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

## 第四节 无锡创达电子有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

## 第五节 鼎贞(厦门)系统集成有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

## 第六节 无锡市江达精细化工有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第七节 陕西华电材料总公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第八节 无锡嘉联电子材料有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第十五章 2020-2026年中国IC封装业前景预测分析

第一节 2020-2026年中国IC封装业前景预测

一、环氧树脂在电子封装应用方面前景开阔

二、太阳能光伏行业对封装材料需求前景光明

第二节 2020-2026年中国IC封装产业新趋势探析

一、新型的封装发展趋势

二、集成电路封装的发展趋势

三、IC封装技术发展趋势

四、IC封装材料市场发展趋势

五、半导体IC封装技术发展方向

第三节 2020-2026年中国IC封装市场前景预测

第四节 2020-2026年中国IC封装市场盈利预测

第十六章 2020-2026年中国IC封装行业发展预测及风险分析

## 第一节 2020-2026年中国IC封装行业供需预测

### 一、市场规模预测

### 二、生产预测

### 三、需求量预测

## 第二节 2020-2026年中国IC封装行业投资机会分析

## 第三节 2020-2026年中国IC封装行业风险分析

### 一、市场供需风险

### 二、经营管理风险

### 三、政策风险

### 四、其它风险

## 第四节 2020-2026年中国IC封装行业发展战略及策略建议

### 一、对行业发展形势的总体判断

### 二、发展战略及市场策略分析

## 图表目录：

图表：2016-2019年中国IC封装产业企业数量及增长率分析 单位：个

图表：2016-2019年中国IC封装产业亏损企业数量及增长率分析 单位：个

图表：2016-2019年中国IC封装产业从业人数及同比增长分析 单位：个

图表：2016-2019年中国IC封装企业总资产分析 单位：亿元

图表：2016-2019年中国IC封装产成品及增长分析 单位：亿元

图表：2016-2019年中国IC封装工业销售产值分析 单位：亿元

图表：2016-2019年中国IC封装出口交货值分析 单位：亿元

图表：2016-2019年中国IC封装行业销售成本分析 单位：亿元

图表：2016-2019年中国IC封装行业费用分析 单位：亿元

图表：2016-2019年中国IC封装行业主要盈利指标分析 单位：亿元

图表：2016-2019年中国IC封装行业主要盈利能力指标分析

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202002/152778.html>